

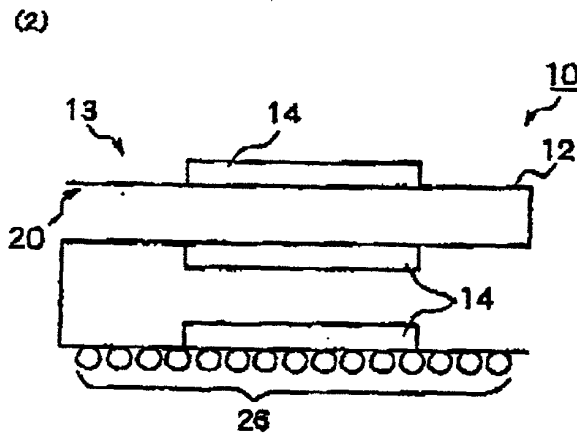
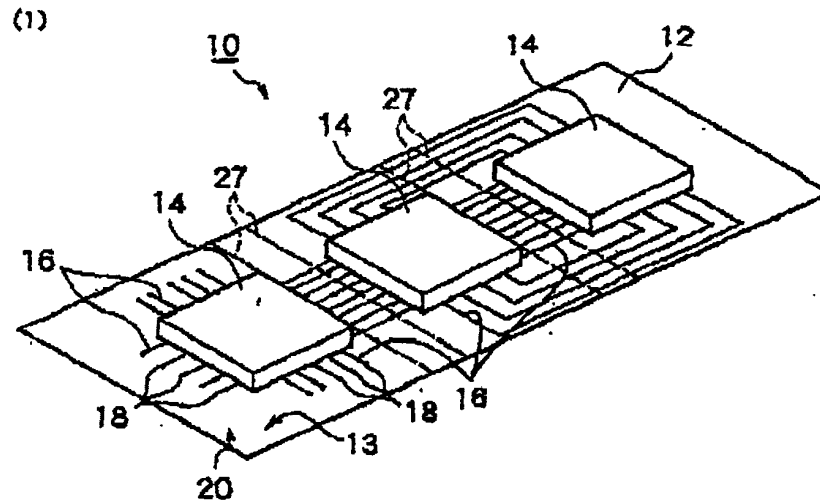
整理番号=J0074549

提出日 平成12年 1月12日

頁: 1/ 5

【書類名】 図面

【図1】



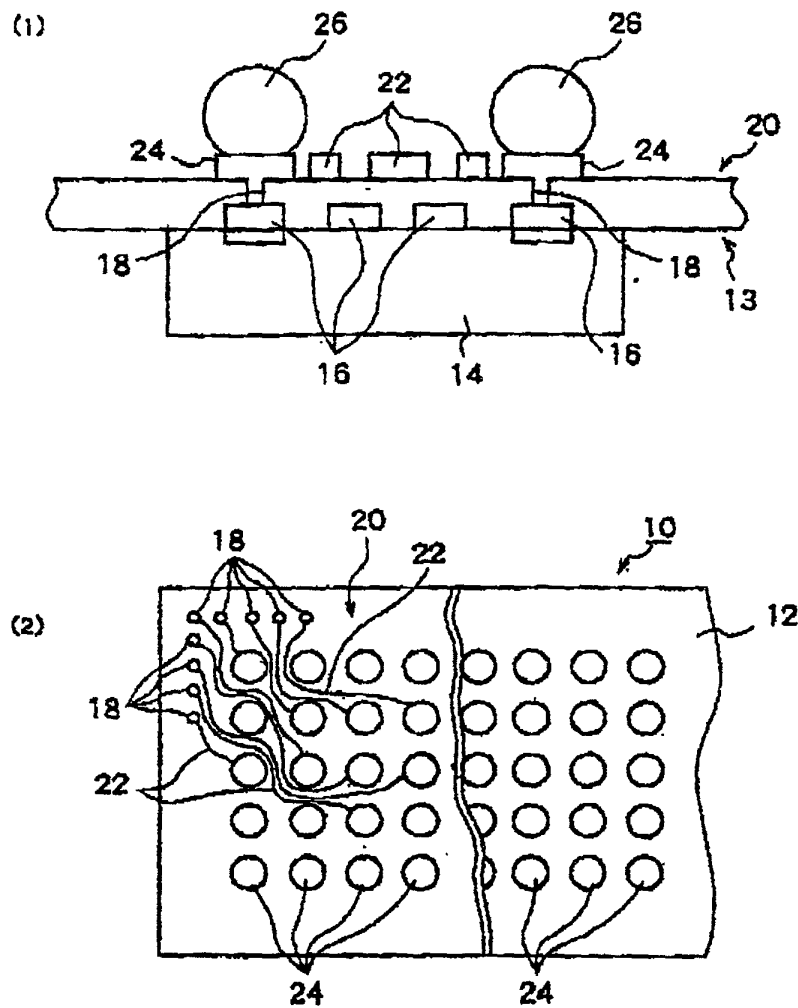
10: SEMICONDUCTOR DEVICE  
12: CONNECTION SUBSTRATE  
14: SEMICONDUCTOR CHIP  
16: 1st METALLIC WIRING

整理番号=J 0 0 7 4 5 4 9

提出日 平成12年 1月12日

頁: 2/ 5

【図2】

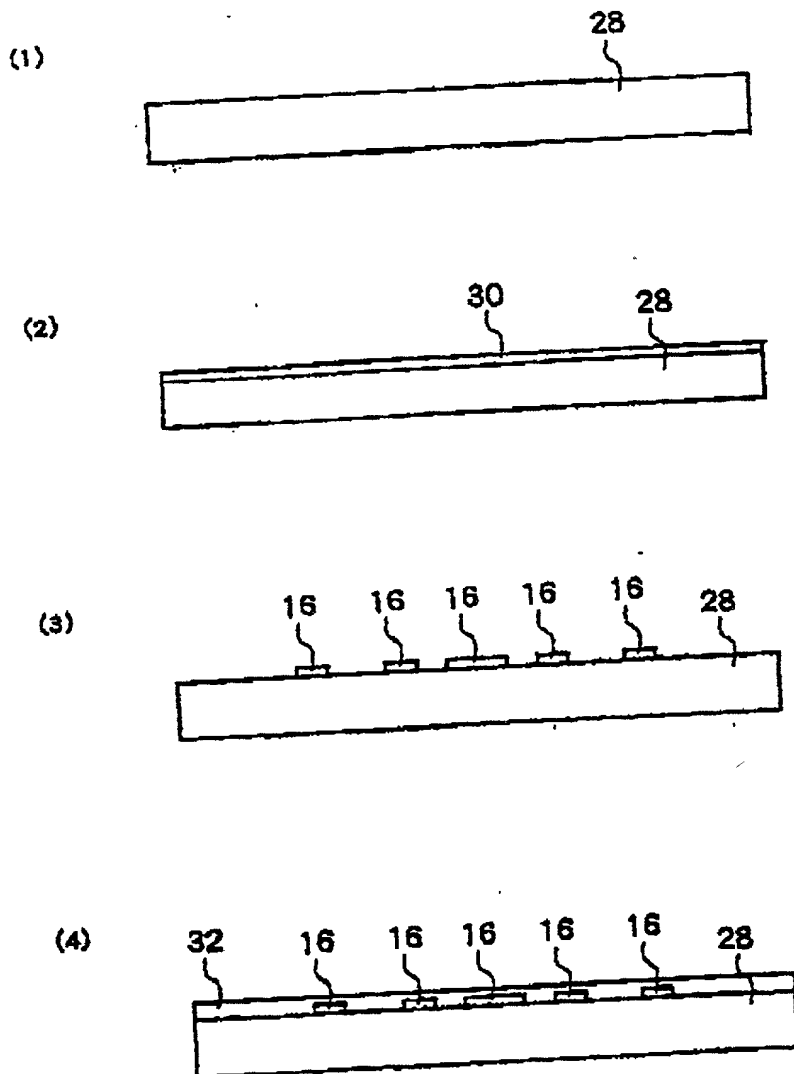


提出日 平成12年 1月12日  
頁: 3/5

頁: 3/5

整理番号=J0074549

【圖3】

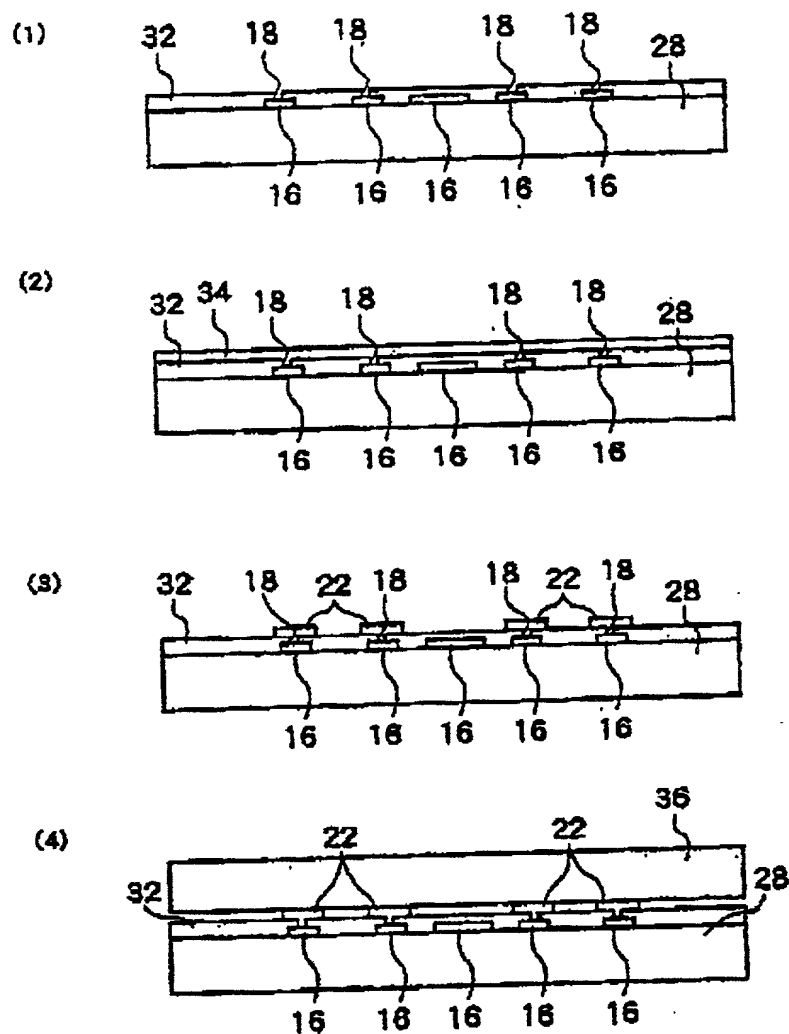


提出日 平成12年 1月12日 第4/5号

頁: 4/

整理番号=J0074649

【图4】



提出日 平成12年 1月12日  
頁: 5/ 6

整理番号=J0074549

【図5】

